

# 台灣業強BGA錫球\_無鉛SAC105\_0.60mm

产品名称	台灣業強BGA錫球_無鉛SAC105_0.60mm
公司名称	中山伟强科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:锡球 材质:Sn98.5-Ag1-Cu0.5 产地:中山
公司地址	中山市三乡镇平南村业强街1号六栋、七栋一楼A区、八栋一楼A区、九栋
联系电话	86 0760 86682368 15362994111

## 产品详情

种类	锡球	材质	Sn98.5-Ag1-Cu0.5
产地	中山	规格	0.6mm

产品说明：

无铅锡球（sn98.5/ag1/cu0.5），25万粒/瓶，直径0.6mm

产品系列：

种类	成份组成	球尺寸	熔点
锡铅	sn63-pb37	0.1mm~0.89mm	183
	sn10-pb90		302
	sn90-pb10		220
	sn62-pb36-ag2		179
无铅	sn96.5-ag3.5		221
	sn95.5-ag4-cu0.5		217
	sn98.2-ag2.6-cu0.6		217
	sn96.5-ag3-cu0.5		217
	sn98.5-ag1-cu0.5		217

产品特色：

.每颗球都经过多次精密筛选、球径一致并降低客户植球停线成本

.解决各式ic与精密，电子零组件之接脚问题

.领先国内同业获得国际级ic大厂认证且已销售达8年以上，产品可替代性不易

.特殊配方，加上材料及制程皆严密控制并专机专用，无论在真圆度、含氧程度及光泽度均领先竞争对手

.全球将近2成之ic对装业者采用本公司锡球，是唯一可与日本企业竞争且具成长性之关键封装材料厂

.国内最早推出环保无铅锡球且已取得授权，未来商机无限

.产品符合rohs规范

品质认证：

1996年通过iso 14001认证

1998年通过qs 9000认证

1999年通过ohsas 18001认证

2000年通过iso 9001&gb/t 19001认证

2001年通过gb/t 28001认证

检验标准：

备注：

0.76锡球主要用在p3的主板和一些老式的显卡上.

0.60和0.50主要用在p4以上的主板上的南北桥和笔记本上的南北桥以及显卡上。

0.45主要用在bga封装的内存条上.

0.60 0.50 0.45也基本上用在手机和数码mp3，mp4和数码相机的bga芯片。